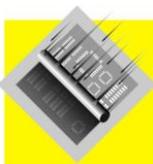


ZESTRON® SW

Medium zur Unterseitenreinigung im Schablonendrucker



ZESTRON® SW ist ein lösemittelbasierendes Medium mit hohem Flammpunkt, das in Zusammenarbeit mit führenden Druckerherstellern speziell für die Reinigung der Schablonenunterseite in SMT-Druckern ohne Absaugung entwickelt wurde. Die Reinigung mit ZESTRON® SW liefert reproduzierbare, sichere Reinigungsergebnisse. In Verbindung mit der rückstandsfreien Trocknung wird dadurch die Zuverlässigkeit des Druckprozesses erhöht.

Anwendungsbereich: Schablonenunterseite		Weitere Informationen zum Produkt:
Lotpasten (ungelötet)	++	Technische Information 3: Übersicht bzgl. der Materialverträglichkeit Technische Information 4: Zusatzinfo zum Thema Unterseitenreinigung in Druckern. Anwendungsempfehlung: Einsatzparameter für die Evaluation im SMT Drucker.
SMT-Kleber bzw. Leitkleber	+	

++ sehr empfohlen + empfohlen 0 möglich, aber nicht empfohlen - nicht empfohlen

Technische Zentren - ① Amerika, ② Europa, ③ Malaysia, ④ Nord-China, ⑤ Süd-China
Lösungen für Reinigungsprozesse unter Produktionsbedingungen



Kontaktieren Sie ZESTRON's Prozessingenieure für kostenlose Reinigungsversuche:
 Telefon: +49-841-635-26; E-Mail: techsupport@zestron.com

Vorteile gegenüber anderen Reinigungsmedien

- Durch sein weites Prozessfenster entfernt ZESTRON® SW zuverlässig gängige Lotpasten auf der Schablonenunterseite.
- Trocknet schnell und hinterlässt nach dem Trockenwischen keine Rückstände auf der Schablone.
- Gute Kantenstabilität und vermindert Lotperlenbildung (siehe Technisches Informationsblatt 4).
- Im Gegensatz zu Isopropanol (Flammpunkt: 12°C) ermöglicht ZESTRON® SW mit einem Flammpunkt von 67°C einen sicheren Einsatz im Schablonendrucker.
- ZESTRON® SW basiert auf halogenfreien, organischen Lösemitteln.
- ZESTRON® SW ist biologisch abbaubar.
- Minimiert die Zahl der notwendigen Reinigungszyklen.

Vor der Reinigung von Kunststoffteilen bitte unser Technisches Informationsblatt 3 einsehen.

ZESTRON® SW ist von führenden Herstellern von Schablonendruckern für den Einsatz freigegeben. Einzelfreigaben können angefordert werden.

Prozesse	1. Reinigen	2. Trocknen
SMT-Drucker mit/ohne Absaugung	ZESTRON® SW	Trockenes Vlies oder Vakuumsaugung

Technische Daten		
Dichte	(g/ccm) bei 20°C	0,89
Oberflächenspannung	(mN/m) bei 25°C	27,6
Siedetemperatur	°C	100 – 171
Flammpunkt	°C	67
pH-Wert	10g/l H ₂ O	Neutral
Dampfdruck	(mbar) bei 20°C	Ca. 3
Anwendungstemperatur	°C	Raumtemperatur
Einsatzkonzentration	Fertigmischung	Unverdünnt

PRODUCT FEATURES



Umfangreich getestet und zur Reinigung von bleifreien Lotpasten geeignet



Das Produkt ist frei von bedenklichen Inhaltsstoffen gemäß der SIN- & SVHC-Listen



100% konform mit den EU Richtlinien (RoHS 1 & 2, WEEE)

Umwelt- und Arbeitsschutz:

- ZESTRON® SW ist frei von halogenierten Verbindungen formuliert und biologisch abbaubar.
- Für den Einsatz am Arbeitsplatz beachten Sie bitte die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Verfügbarkeit/Lagerung

- ZESTRON® SW in den Gebindegrößen von 1L, 5L, 25L und 200 L verfügbar.
- Das Produkt ist nach EU-Norm kennzeichnungspflichtig, unterliegt aber nicht der Gefahrgutverordnung.
- Es wird empfohlen, ZESTRON® SW im Originalgebinde in einem Temperaturbereich von 5°C - 30°C zu lagern.
- Luftdicht verschlossen ist das Produkt unter diesen Bedingungen mindestens 5 Jahre haltbar.

Alternative Produktempfehlung

- Für die wasserbasierende Reinigung der Schablonenunterseite in Druckern mit einer Vakuumtrocknung wird VIGON® SC 200 empfohlen.